

2026.03.16 (월)

GROWTH RESEARCH

[GTC2026 산업보고서]

구리에서 빛으로, 챗봇에서
에이전트로, 화면에서 현실로
GTC 2026 완전 해부

Analyst. 한용희, 김주형



목차

Part 1. GTC 2026: 엔비디아가 그리는 AI의 다음 챕터

Part 2. 관전포인트 ① 하드웨어 — Vera Rubin

Part 3. 관전포인트 ②. 에이전틱 AI 소프트웨어

Part 4. 관전포인트 ③. 피지컬 AI & AI Factory

기업분석

성호전자(043260)

PI첨단소재 (178920)

Intro

GTC 2026이 3월 16일(월)부터 19일(목)까지 미국 캘리포니아 산호세(San Jose)에서 개최된다. 기조연설은 SAP 센터에서, 전시와 세션은 McEnergy Convention Center를 중심으로 진행되며, 190개국 이상에서 3만 명이 현장을 찾을 것으로 예상된다. 1,000개 이상의 기술 세션과 300개 이상의 전시 부스가 운영되는 이 행사는 규모 자체만으로도 이미 기술 업계 최대 행사 중 하나다.

GTC는 GPU Technology Conference의 약자로, 세계 최고의 AI 반도체 기업 엔비디아가 매년 주최하는 기술 컨퍼런스다. **2009년 GPU 개발자들을 위한 작은 학술 모임으로 출발했으나, 엔비디아가 AI 반도체 시장을 주도하면서 전 세계 개발자·연구원·기업인이 모이는 세계 최대 AI 컴퓨팅 컨퍼런스로 성장했다.** GTC는 컴퓨팅 패러다임이 전환되는 **변곡점마다 그 방향타 역할을 해왔다.** 2012년 AlexNet이 엔비디아 GPU로 딥러닝 혁명의 서막을 열었고, 2024년 블랙웰(Blackwell) 아키텍처를 기점으로 현재의 'AI 인프라 투자 사이클'이 본격화됐다.

이번 GTC 2026은 그 연장선에서 AI 인프라 패러다임 전환의 다음 챕터가 열리는 자리다. **차세대 GPU 플랫폼 Vera Rubin의 세부 스펙과 출하 일정이 확정되고, 에이전틱 AI 소프트웨어 생태계의 윤곽이 구체화되며, 피지컬 AI의 상용화 모멘텀이 가시화되는 기점이 될 것으로 판단된다.** 본 리포트에서는 이 세 가지 관전 포인트를 중심으로 국내 기업들의 실질적인 수혜 가능성과 수주 타이밍을 투자 관점에서 점검했다.

Part 1. GTC 2026: 엔비디아가 그리는 AI의 다음 챕터

GTC 2026은 3월 16일(월)부터 19일(목)까지 미국 캘리포니아 산호세(San Jose)에 서 개최된다. 기조연설은 SAP 센터에서, 전시와 세션은 McEnergy Convention Center 를 중심으로 진행되며, 190개국 이상에서 3만 명이 현장을 찾을 것으로 예상된다. 1,000개 이상의 기술 세션과 300개 이상의 전시 부스가 운영되는 이 행사는 규모 자체 만으로도 이미 기술 업계 최대 행사 중 하나다.

GTC는 GPU Technology Conference의 약자로, 세계 최고의 AI 반도체 기업 엔비 디아가 매년 주최하는 기술 컨퍼런스다. 원래 2009년 GPU 개발자들을 위한 작은 학술 모임으로 출발했으나, 엔비디아가 AI 반도체 시장을 주도하면서 전 세계 개발자·연구원·기업인이 모이는 **세계 최대 AI 컴퓨팅 컨퍼런스**로 성장했다.

GTC는 컴퓨팅 패러다임이 전환되는 변곡점마다 그 방향타 역할을 해왔다.

1) 태동기('09~'12)

GTC는 처음부터 AI 행사가 아니었다. GPU를 게임이 아닌 과학 계산에 활용하려는 연구자들의 학술 모임 성격으로 시작됐다. 이 시기 **엔비디아는 CUDA(병렬 컴퓨팅 플랫폼) 생태계를 구축하는 데 집중했다.** 게임용 그래픽 칩을 과학 연산에 쓰겠다는 발상은 당시만 해도 비주류에 가까웠지만, 이 기간 심어진 CUDA 생태계는 이후 AI 혁명의 인 프라가 됐다.

GTC 2026 일정

NVIDIA GTC 2026

March 16-19
San Jose, CA



GTC 2009 초창기 모습



자료: NVIDIA, 그로스리서치

자료: NVIDIA, 그로스리서치

2) 전환기('12~'16)

2012년은 GTC가 성격을 바꾸는 결정적 계기가 된 해다. AI 연구팀 '슈퍼비전'이 개발한 딥러닝 모델 AlexNet이 이미지 인식 대회(ILSVRC)에서 오차율 15.3%를 기록하며 압도적인 우승을 거뒀다. 기존 수동 프로그래밍 방식 팀들의 오차율이 26%대였다는 점을 감안하면 매우 압도적인 격차를 보였다. 결정적인 점은 AlexNet이 CPU가 아닌 엔비디아 GPU 2개를 병렬로 연결해 학습됐다는 것이다. **GPU가 AI 연산에서 본격적으로 활용되기 시작하면서, GTC도 자연스럽게 'AI 컨퍼런스'로 정체성이 바뀌어 갔다.**

3) 확장기('18~'22)

2018년 RTX 출시와 2022년 옴니버스(Omniverse) 플랫폼 공개를 기점으로, GTC는 GPU 행사를 넘어 디지털 트윈과 가상 세계를 설계하는 '플랫폼 기업'으로서 엔비디아의 정체성을 선포하는 무대가 됐다. 이 시기부터 GTC는 반도체 전문가만의 행사가 아니라, 제조·자동차·미디어·의료 등 다양한 산업의 기업 의사결정자들이 주목하기 시작했다.

4) 폭발기('23~현재)

2024년 블랙웰(Blackwell) 아키텍처 출시를 기점으로 AI 모델의 규모가 폭발적으로 커졌다. 수만 개의 GPU를 하나의 거대한 단일 컴퓨터처럼 묶어 운영하는 기술이 본격화됐고, 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자 규모는 수조 원 단위에서 수십조·수백조 원 단위로 올라섰다. 현재 우리가 목격하고 있는 **'AI 인프라 투자 사이클'의 실질적인 출발점이 바로 이 시기**다. 여기에 더해 로봇틱스와 자율주행을 실시간으로 처리하는 Physical AI의 비전이 GTC의 핵심 의제로 자리 잡기 시작했다.

GTC 역사타임라인

'09 ~ '12 01 태동기 GPGPU · CUDA 생태계 구축기	'12 ~ '16 02 전환기 AlexNet · 딥러닝 혁명의 시발점	'18 ~ '22 03 확장기 RTX · 옴니버스 플랫폼 기업 선언	'23 ~ 현재 04 폭발기 ★ 블랙웰 · 피지컬 AI AI 인프라 대전환
<p>GPU가 AI 연산의 가능성을 처음 증명한 시기</p> <ul style="list-style-type: none"> GPGPU 게임용 GPU → 과학 계산 병용화 CUDA 엔비디아 병렬 컴퓨팅 플랫폼 출시 학습 도입 AI-연구자 중심 개발자 컨퍼런스 <ol style="list-style-type: none"> GPU를 과학계산(GPGPU)에 활용하려는 개발자-연구자의 학습 도입 성격이 강했던 초기 단계 CUDA 병렬 컴퓨팅 플랫폼 생태계 구축이 주역하여 AI 연산의 씨앗을 심은 시기 	<p>GPU가 딥러닝 혁명의 방아쇠를 당기다</p> <ul style="list-style-type: none"> AlexNet ILSVRC 이미지 인식 대회 압도적 우승 딥러닝 혁명 오차율 15.3% vs 기존 26%—격차 증명 정체성 전환 'AI 컨퍼런스'로 새말 완전 전환 <ol style="list-style-type: none"> AlexNet이 GPU 2개 병렬 학습만으로 ILSVRC 우승, 인공지능경쟁의 가능성을 전 세계에 각인시킨 분기점 이 시점부터 빅테크들의 GPU 도입이 본격화되며 GTC는 명실상부한 'AI 컨퍼런스'로 탈바꿈 	<p>칩 제조사를 넘어 소프트웨어 플랫폼으로 피벗</p> <ul style="list-style-type: none"> RTX ('18) 레이 트레이싱 — 실시간 그래픽 혁신 옴니버스 ('22) 디지털 트윈 · 가상 협업 플랫폼 출시 플랫폼 선언 하드웨어사 → 소프트웨어 생태계 기업 <ol style="list-style-type: none"> '18년 RTX 아키텍처, '22년 옴니버스 출시로 디지털 트윈·가상 세계 설계 플랫폼 기업 정체성 선포 단순 칩 판매를 넘어 소프트웨어 생태계 확장으로 피벗하며 플랫폼 기업으로 포지셔닝 완료 	<p>빅테크가 수백조 원을 AI 인프라에 배당하다</p> <ul style="list-style-type: none"> 블랙웰 ('24) 수만 GPU → 단일 컴퓨터처럼 작동 수백조 투자 빅테크 AI 인프라 투자 시대 본격 개막 피지컬 AI 로봇틱스·자율주행 실시간 연산 지원 <ol style="list-style-type: none"> '24년 블랙웰 출시, NVLink 기반 초대형 클러스터로 수만 개 GPU가 단일 컴퓨터처럼 작동하는 시대 개막 빅테크 수십~수백조 원 규모 AI 인프라 투자 확장, 피지컬 AI(Physical AI)로 현실 세계 안전까지 확장

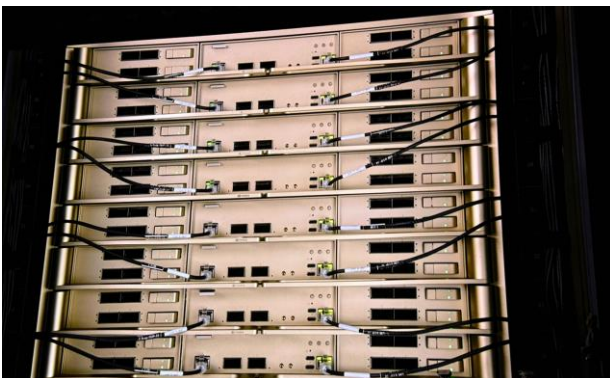
자료: 그로스리서치

Part 2. 관전포인트 ① 하드웨어 — Vera Rubin

Vera Rubin은 AI 추론(Inference) 중심으로 설계된 GPU다. 2022~2024년 ChatGPT 등장 이후 AI 모델 학습 수요가 폭증하면서 Hopper와 Blackwell이 그 수요를 받아냈다면, 2025년 이후부터는 이미 학습된 모델을 실제로 사용하는 추론 수요가 급격히 커지는 국면으로 전환됐다. 특히 **에이전틱 AI(스스로 판단하고 여러 단계를 실행하는 AI)의 확산으로 추론은 더 자주, 더 오래 돌아가는 구조가 됐고, 추론 인프라 비용이 새로운 병목으로 부상했다.** Vera Rubin은 이 문제를 해결하기 위해 설계됐다. 단일 GPU가 아닌 데이터센터 전체를 하나의 컴퓨팅 단위로 설계해 Blackwell 대비 추론 성능 5배, 토큰당 비용 10분의 1을 목표로 하며, **학습-추론-에이전틱 AI 전 과정에서 지속 가능한 AI 팩토리 구현이 궁극적인 설계 방향이다.**

Vera Rubin은 CES 2026에서 프리뷰 형식으로 먼저 공개됐다. 6칩 통합 플랫폼 구조, 추론 성능 5배-비용 10분의 1 등 주요 수치가 발표됐고, ICMS(Inference Context Memory Storage) 개념도 이 자리에서 처음 소개됐다. 이번 GTC 2026은 그 연장선에서 세부 스펙과 출하 일정이 구체적으로 확정되는 자리다. **실제 벤치마크 성능 수치, 랙 구성별 출하 일정, ICMS로 인한 NAND 수요 규모가 이번 GTC의 핵심 관전 포인트다.** 추가로 CES에서 Spectrum-X Ethernet Photonics(엔비디아 AI 서버용 네트워크 스위치 제품군인 Spectrum-X에 CPO 기술을 적용한 버전) 언급이 있었던 만큼, CPO 전용 랙인 NVL576에 대한 공식 발표 여부도 주목할 필요가 있다.

Vera Rubin NVL72 랙 시스템



자료: NVIDIA, 그로스리서치

그로스리서치 GROWTH RESEARCH

Vera Rubin 관련 CES 2026과 GTC 2026 내용

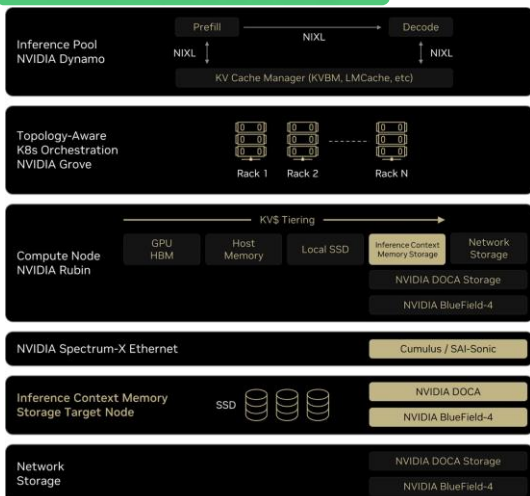
구분	CES 2026 (공개 완료)	GTC 2026 (이번 관전 포인트)
플랫폼 구성	6칩 통합 구조 발표 (Rubin GPU-Vera CPU-NVLink 6 등)	랙 구성별 출하 일정 확정 (NVL72-NVL144-NVL576 출하 시기)
성능 수치	추론 5배-비용 1/10 선언 (Blackwell 대비)	실제 벤치마크 결과 공개 CSP(AWS-Azure-GCP) 납품 계획 확정
스토리지	ICMS 개념 및 효과 발표 (KV캐시 오프로드 구조)	NAND 수요 규모 확정 공급사(삼성-SK하이닉스) 선정 공개
네트워크	Spectrum-X 광연결 언급 (Ethernet Photonics 예고)	CPO 탑재 랙(NVL576) 공식 발표 및 스펙 확정 (광부품 공급망 확인)
차세대 예고	없음	Feynman 아키텍처(2028) 첫 공개 (다음 세대 로드맵 확인)

자료: 그로스리서치

이번 GTC에서 국내 산업 관점의 핵심 관전 포인트는 메모리와 CPO 두 가지다. 메모리에서는 HBM4 공급 구도와 ICMS로 인한 NAND 수요 확장이 주요 체크포인트다. Vera Rubin은 JEDEC 표준(8Gb/s)을 크게 상회하는 10~11Gb/s 이상의 속도를 HBM4 요건으로 제시하고 있으며, 초기 공급은 엔비디아 위주로 집중될 가능성이 높다. **GTC에서 엔비디아가 공급사를 구체적으로 언급하거나 납품 일정이 공개될 경우 국내 메모리 업체 주가에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. ICMS의 구체적인 채택 규모가 확정될 경우에는 eSSD 관련 국내 부품·장비주 수혜로 이어질 가능성이 있다.** ICMS에 대한 더 자세한 관련 세부 내용은 이전 NAND 산업보고서(2026.02.23)를 작성했으니, 참고하길 바란다.

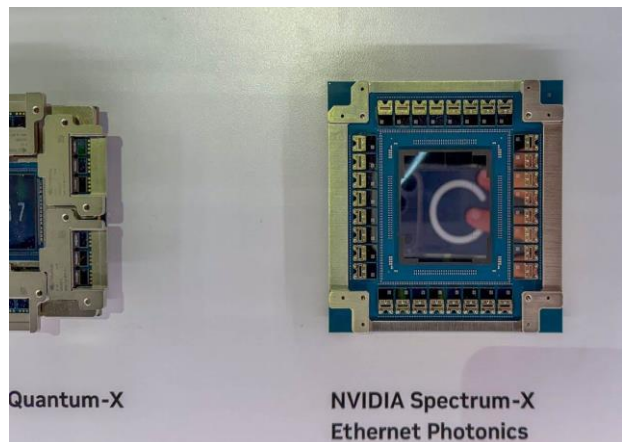
CPO(Co-Packaged Optics) 역시 이번 GTC의 핵심 관전 포인트다. 기존 AI 서버는 GPU끼리 구리 케이블로 연결되는 구조였으나, 데이터 규모가 커질수록 전력 소모가 급증하고 신호 손실이 발생하는 구조적 한계에 직면하고 있다. **CPO는 광학 부품을 스위치 칩 패키지 안에 직접 내장해 구리를 광신호로 대체하는 방식으로 이를 해결한다.** 전력 효율 5배 향상, 신호 안정성 64배 개선이 가능하며, Vera Rubin급 초대형 클러스터인 NVL576에서는 구리로는 내부 통신 속도를 감당할 수 없는 구조적 한계에 이미 도달한 상황이다. **이번 GTC에서 NVL576 출하 일정이 구체적으로 확인될 경우, CPO 관련 공급망 전반의 수혜 타이밍이 가시화될 것으로** 판단된다.

ICMS 아키텍처 다이어그램



자료: NVIDIA, 그로스리서치

Spectrum-X Ethernet Photonics CPO 스위치



자료: substack, 그로스리서치

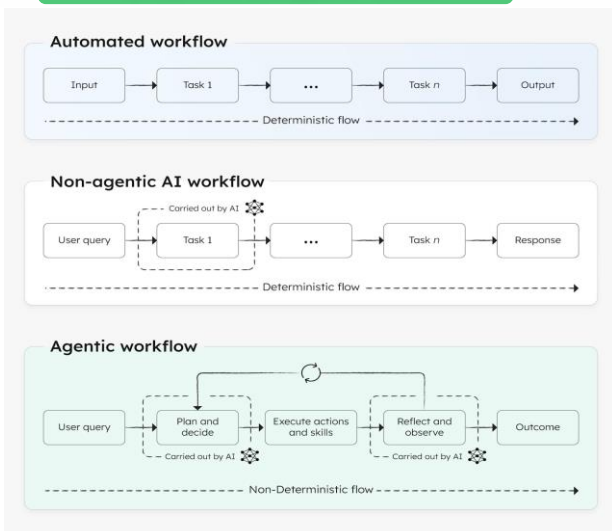
Part 3. 관전포인트 ②. 에이전틱 AI 소프트웨어

AI 시장의 흐름은 단계적으로 진화하고 있다. 1단계는 AI 모델을 만드는 학습(Training) 단계로 Hopper와 Blackwell이 이 수요를 받아냈고, 2단계는 학습된 모델을 실제로 사용하는 추론(Inference) 단계로 Vera Rubin이 담당한다. 이번 GTC의 소프트웨어 핵심은 3단계, AI가 스스로 판단하고 일하는 에이전틱 AI다. 기존 AI가 명령에 한 번 답하고 끝나는 1회성 구조였다면, 에이전틱 AI는 명령 하나로 계획·실행·확인까지 스스로 반복 처리하는 방식으로 작동한다.

이번 GTC에서 엔비디아가 공개할 예정인 오픈소스 엔터프라이즈 AI 에이전트 플랫폼 NemoClaw에 주목해야 한다. NemoClaw는 기업이 AI 에이전트를 직접 구축·배포할 수 있게 하는 소프트웨어로, Salesforce, Cisco, Google, Adobe, CrowdStrike 등과 파트너십 논의가 진행 중인 것으로 알려져 있다.

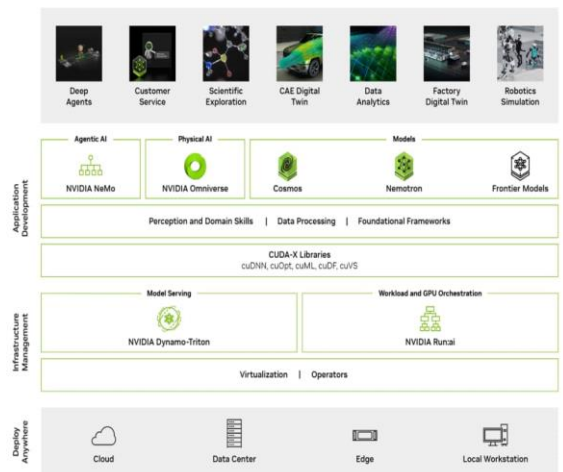
NemoClaw를 주목해야 하는 이유는 CUDA와 같은 깊은 해자를 소프트웨어 수준에서 구축할 수 있다는 평가 때문이다. NeMo-Dynamo-BlueField-4-Vera Rubin과 결합할 때 최적 성능을 발휘하는 구조로 설계돼 있어, 개발자가 NemoClaw로 에이전트를 만들기 시작하면 다른 하드웨어로의 전환 비용이 자연스럽게 높아진다. 하드웨어 세대 교체와 소프트웨어 생태계 구축이 동시에 진행되고 있다는 점에서, NemoClaw는 엔비디아의 중장기 경쟁 우위를 가늠하는 핵심 지표로 판단된다.

에이전틱 AI 워크플로우 구조도



자료:orkes, 그로스리서치

NVIDIA AI 풀스택 소프트웨어 구조



자료:NVIDIA, 그로스리서치

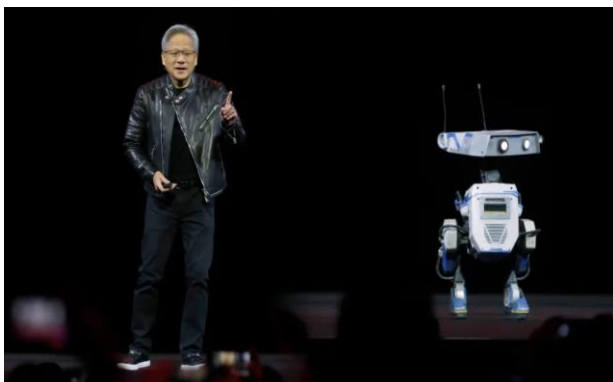
Part 4. 관전포인트 ③. 피지컬 AI & AI Factory

지금까지 AI는 디지털 공간 안에서만 작동했다. 피지컬 AI는 AI가 물리적 공간으로 나오는 단계로, 엔비디아가 집중하고 있는 또 다른 성장 축이다. **이번 GTC 2026에서도 작년 GTC 2025에 이어 피지컬 AI가 주요 관전 포인트로 부각될 것으로 예상된다.** 이번 GTC 2026의 핵심은 로봇 개발의 표준이 엔비디아 중심으로 수렴되고 있는지 여부다.

엔비디아는 로봇 개발 전 밸류체인에 걸쳐 기술 스택을 구축해 놓은 상태다. 휴머노이드 로봇 전신 제어용 오픈소스 AI 모델인 GROOT N1.6, 현실과 동일한 가상 환경에서 로봇을 훈련시키는 시뮬레이션 플랫폼 Isaac Lab-Arena, 데이터 수집·모델 학습·배포까지 전 과정을 통합 관리하는 운영 플랫폼 OSMO가 그 핵심이다. 이 기술 스택을 일단 채택하면 로봇 훈련 데이터와 모델이 모두 엔비디아 플랫폼에 축적되는 구조로, 소프트웨어와 마찬가지로 전환 비용이 자연스럽게 높아진다.

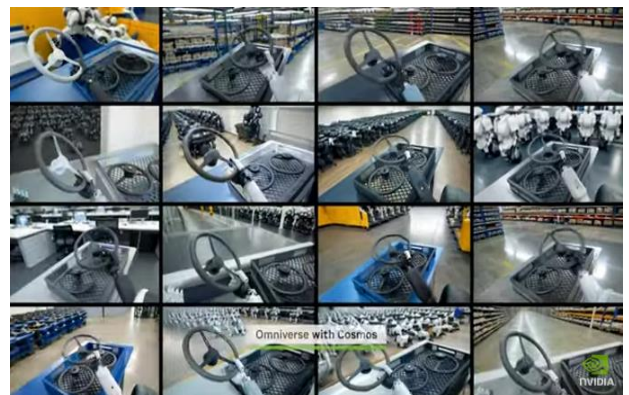
현재 Boston Dynamics·Figure 등 로봇 기업을 비롯해 Caterpillar(건설·광업)·LG전자·Amazon Robotics 등 제조·물류·항공·의료 분야에 걸쳐 광범위한 파트너십이 진행 중이다. **이번 GTC에서는 파트너십 단계를 넘어 실제 수주 및 납품 계약으로의 전환 여부, 그리고 신규 산업군 파트너 추가 발표 여부를 중점적으로 확인해야 할 시점이다.**

GTC2025 GROOT N1 발표



자료:NVIDIA, 그로스리서치

Isaac GROOT N1 비디오 데이터 학습 과정



자료:NVIDIA, 그로스리서치

Part 5. 관련기업

GTC2026 관련 기업

기업명	기업개요	시가총액
㉠ 메모리 · HBM4		
HBM4 메모리 삼성전자	<ul style="list-style-type: none"> '69년 설립, '75년 상장 (코스피) 주요 사업: 반도체(DS), MX(스마트폰), 디스플레이, 가전(CE) HBM4 공급: 10~11 Gb/s 속도 충족, NVIDIA Rubin 플랫폼 공식 인증 획득 GTC 2026 플래티넘 스폰서 참가, AI 팩토리 협력 방안 발표 예정 HBM4 최초 양산으로 핵심 공급 업체로 부상 	1,086조원
HBM4 메모리 SK하이닉스	<ul style="list-style-type: none"> '83년 설립, '96년 코스피 상장 주요 사업: D램·낸드 설계·제조, HBM 시리즈 (HBM3E, HBM4) HBM4 1차 공급사로 NVIDIA와 최적화 협업 진행 중 (점유율 ~50% 유지) 최태원 SK그룹 회장 GTC 2026 최초 참석 Gen6 컨트롤러 SSD·HBF(High Bandwidth Flash) 프로토타입 첫 공개 가능성 	648조원
㉡ CPO · 광부품		
CPO 광장비 성호전자	<ul style="list-style-type: none"> '68년 설립, '99년 코스닥 상장 주요 사업: 전자부품(콘덴서·파워) + 자회사 에이디에스테크(ADS Tech) 광장비 에이디에스테크: 2015년부터 NVIDIA 멜라녹스에 광트랜시버 정렬 장비 공급 2026년 ADS Tech 매출 903억원(+64%), 영업이익 433억원(+70%) 전망 (미래에셋) GTC 2026 CPO 상용화(Q3 2026) 공식화 시 수주 파이프라인 가시화 	3조 5,745억원
CPO 광트랜시버 오이솔루션	<ul style="list-style-type: none"> '03년 설립, '14년 코스닥 상장 주요 사업: 5G·AI 데이터센터용 광트랜시버 설계·제조 OFC 2026 展 1.6Tbps OSFP 광트랜시버 세계 최초 공개 (기존 800G 대비 2배) CPO 외부광원(External Light Source) 모듈 독자 개발 — CPO 생태계 내 핵심 부품 레이저다이오드 내재화 성공으로 원가 경쟁력·공급 안정성 동시 확보 	4,320억원
CPO 소재 Pi첨단소재	<ul style="list-style-type: none"> '08년 설립, '19년 코스피 상장 주요 사업: 폴리이미드(PI) 필름·바니시 — 전 세계 점유율 1위 CPO 핵심 소재: 광집적회로(PIC) 기반 절연·방열에 PI 필름 필수 적용 Physical AI 수혜: 로봇·드론 경량 구조에 PI 기반 FPCB 수요 급증 기대 2026E 매출 2,880억원(+9%), 영업이익 540억원(+30%) 전망 (리서치알용) 	5,723억원
㉢ Physical AI · AI Factory		
AI Factory 디지털트윈 LG디스플레이	<ul style="list-style-type: none"> '85년 설립, '04년 코스피·NYSE 동시 상장 주요 사업: OLED·LCD 패널 설계·제조 국내 디스플레이 최초 GTC 2026 공식 초청 참가 (엔비디아 측 직접 초청) NVIDIA PhysicsNeMo 기반 디지털 트윈 패널 툴(DPS) 시연 — AI 팩토리 적용 사례 향후 AX(AI 전환) 전략과 OLED 공정 AI 혁신 방향 발표 예정 	5조 6,800억원
Physical AI 로보틱스 현대자동차	<ul style="list-style-type: none"> '67년 설립, '74년 코스피 상장 주요 사업: 완성차·부품 + 보스턴다이나믹스(BD) 로봇 + 모셔널 자율주행 NVIDIA AlphaMayo R1 자율주행 플랫폼 도입 검토 및 기술 협업 구체화 예정 보스턴다이나믹스(BD) IPO 가시화 — 기업가치 50~100조원 추정, 현대차 28% 보유 모셔널 참가 — Physical AI 기업 전환 로드맵·로보틱스 기술력 공유 	105조 8,598억원

자료 : 그로스리서치

성호전자(043260)

에이디에스테크 인수, CPO 상용화의 핵심 공급망 선점

투자포인트

에이디에스테크 자회사로 보유

동사는 1973년 진영전자로 설립되어 2000년 성호전자로 사명을 변경했으며, 2001년 코스닥에 상장했다. 전원공급장치·필름콘덴서·증착필름 제조를 주요 사업으로 영위하고 있다. 투자 관점에서 주목해야 할 핵심은 CPO 관련 광모듈 정렬 장비 전문 기업인 에이디에스테크를 자회사로 보유하고 있다는 점이다.

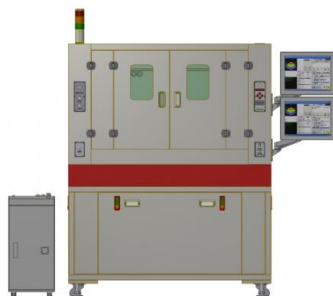
국내 유일의 CPO 정렬 장비 기업, 에이디에스테크 인수

에이디에스테크는 2000년 설립된 광모듈 정렬 장비 전문 제조업체로, AI 데이터센터용 광통신 장비의 핵심 모듈인 광트랜시버 내부의 렌즈·칩·광섬유를 정렬하는 장비를 제조한다. 국내 유일의 광트랜시버 및 CPO 정렬 장비 생산 기업이라는 점에서 CPO 시장 개화의 직접적인 수혜 기업으로 평가된다. 동사는 2025년 12월 에이디에스테크 지분 87.5%를 2,800억 원에 인수하기로 결정했으며, 2026년 2월 중순 최종 인수를 완료했다. 이번 인수를 계기로 에이디에스테크의 지분가치가 시장에서 재평가되면서 동사 주가는 최근 큰 폭으로 상승하는 흐름을 보였다.

엔비디아 Mellanox 공급사, 미중 갈등 수혜로 독보적 위치 확보

에이디에스테크는 엔비디아의 자회사인 네트워크 장비 기업 **멜라녹스(Mellanox)**에 필수 장비를 공급하고 있으며, 2020년부터 엔비디아 본사와 차세대 네트워크 관련 기술을 공동 개발하며 파트너십을 이어오고 있다. 동사의 핵심 경쟁력은 머리카락보다 얇은 광섬유를 나노미터 단위의 오차 없이 칩과 정밀하게 정렬하는 장비 기술에 있으며, 이 분야에서 독보적인 기술력을 보유한 기업은 전 세계적으로 손에 꼽힌다. 여기에 더해 가장 강력한 경쟁사였던 독일의 피컨텍(ficonTEC)이 중국계 자본에 인수되면서, **미중 갈등이 심화되는 국면에서 북미 시장 내 에이디에스테크의 입지는 사실상 대체 불가능한 수준으로 강화됐다.** CPO 시장이 본격적으로 개화하는 시점에서, 동사는 핵심 공급망 내 독보적인 위치를 선점하고 있는 기업으로 판단된다.

에이디에스테크 광모듈정렬장비



Mellanox 광모듈 장비



자료 : 에이디에스테크, 그로스리서치

그로스리서치 GROWTH RESEARCH

자료 : NVIDIA, 그로스리서치

PI첨단소재 (178920)

1위 캐시카우 위에서 피어나는 차세대 성장 스토리

투자포인트

GTC2026 상용화, 가장 준비된 기업

동사는 2008년 코오롱인더스트리와 SKC의 PI필름 사업부 분할합병으로 설립됐으며, 2023년 아케마코리아홀딩으로 최대주주가 변경됐다. 국내 유일의 PI필름 제조사로, 다양한 용도의 PI필름과 바니쉬·파우더·성형품을 생산하는 것을 주력 사업으로 영위하고 있으며, 2014년부터 글로벌 PI필름 시장 점유율 1위를 유지하고 있다.

PI고체 필름 시장 세계 1위, 검증된 기술력이 경쟁 우위의 핵심

동사는 폴리이미드(PI) 고체 필름 시장에서 전 세계 1위 점유율을 차지하고 있다. PI 고체 필름은 수백 도의 고열을 견디고 전기를 차단해 첨단 기기 내부 부품을 보호하는 소재로, 영하 269도의 극저온부터 400도의 고열까지 버티면서 전기를 완벽히 차단하는 특성을 갖는다. 동사는 이러한 극한 환경 대응 기술력을 바탕으로 1위 시장 점유율을 선점했으며, 스마트폰 FPCB와 방열 시트용 원단이라는 확실한 캐시카우를 통해 안정적인 현금흐름을 창출하고 있다.

피지컬 AI·CPO 모두에 걸친 이중 성장 동력

이번 GTC 2026과 관련하여 동사는 피지컬 AI와 CPO 두 가지 방향에서 성장 동력을 확보하고 있다. 피지컬 AI 측면에서는 로봇 관절에 탑재된 수많은 모터에서 고열과 고압 전류가 발생하는데, 이때 절연 및 내열 구리선을 보호하는 필수 절연 테이프에 동사의 PI 고체 필름이 활용될 수 있다. 스마트폰 FPCB에 이어 피지컬 AI라는 새로운 시장이 열리면서, 기존 캐시카우를 기반으로 한 추가 수혜 가능성이 높아지고 있는 국면이다.

CPO 측면에서는 액상 PI로의 사업 확장이 중장기 성장동력으로 주목된다. CPO 기술이 제대로 구현되기 위해서는 반도체 옆에서 녹지 않고 빛의 경로를 만들어주는 액체 코팅 소재가 필요한데, 동사는 이 액상 PI 분야에서 연구개발을 진행 중이다. CPO 시장이 아직 초기 단계인 만큼, 동사가 액상 PI에서 경쟁력을 확보할 경우 CPO 시장의 성장과 함께 동반 성장할 수 있는 구조가 형성될 것으로 판단된다

PI고체 필름



자료 : PI첨단소재, 그로스리서치

그로스리서치 GROWTH RESEARCH

동사 PI Varnish 특징

Zenimid™ PI Varnish 특징



열적 특성

열 안정성이 500°C 이상으로 우수한 내열성을 가지고 있으며, 고온재질에서도 뛰어난 저수분 안정성을 자랑합니다.



전기적, 기계적 특성

극한조건에서도 우수한 전기절연 특성과 연성강도 및 내충격성의 뛰어난 기계적 특성을 유지합니다.



장기보관성

실온에서 매우 낮은 점도를 변화 없이 50년 이상 장기 사용이 가능합니다.



고객 맞춤 설계

고객 사용조건에 맞춰 설계가 가능하며 고열, 침도, 용해 등 요구사항을 반영하여 최적화된 제품을 제공합니다.

자료 : PI첨단소재, 그로스리서치

Compliance Notice

- 동 자료에 게재된 내용은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확히 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
- 동 자료는 투자 판단을 위한 정보제공 및 교육용일 뿐 해당 주식에 대한 가치를 보장하지 않습니다.
- 투자판단은 본인 스스로 하며, 투자 행위와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 동 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
- 당사는 해당 자료를 전문투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 작성자는 해당 기업의 유가증권을 발간 전에 보유하고 있지 않으며, 발간 후에 매수·매도할 수 있습니다.
- 동 자료에 대한 저작권은 그로스리서치에 있습니다. 당사의 허락 없이 무단 복사 및 복제, 대여를 할 수 없습니다.